

Mobilité : Intel mise sur le 14 nm pour bousculer ARM

Viser les TDP (dissipation thermique) de **10 watts (et moins)** avec des performances rehaussées, Intel sait et peut le faire. En témoigne sa démonstration de force lors de la conférence IDF (*Intel Developer Forum*), qui se tient à Shenzhen en Chine.

14 nm pour des machines sans ventilateur

Il y a été question de la puce Braswell, qui succèdera aux Atom Bay Trail (-M et -D). Cette nouvelle gamme de processeurs est notamment destinée au marché des Chromebooks. Ces machines sous les 400 euros qui sont animées par Chrome OS gagnent des parts de marché avec une concurrence des SoC à architecture ARM (comme en témoigne le Chromebook 2 de Samsung). Mais les Braswell ciblent également les PC *low cost*, les hybrides (*2-in-1*) ainsi que les *all-in-ones*.

Ces puces s'appuient sur une **finesse de gravure de 14 nanomètres** (nm), synonyme de frugalité énergétique et de performances. Elles permettent de proposer des machines sans ventilateur.

Braswell viendra se positionner en complément de la future gamme de processeurs [Broadwell](#). Dans cette dernière, on trouvera également des modèles avec faibles TDP : Broadwell-U (TDP de 15 W et 28 W) mais aussi Broadwell-Y (TDP de 3,5 W et 4,5 W) destinés à des tablettes.

Mais avant les Braswell qui devraient être disponibles début 2015, Intel occupera le terrain avec un *refresh* des Bay Trail baptisé Cherry Trail grâce à des processeurs graphiques plus performants et des performances globales rehaussées. Destinés à des tablettes principalement, ils bénéficieront d'une finesse de gravure de 14 nm contre 22 nm pour les actuels Bay Trail.

Atom SoFIA pour les smartphones *low cost*

Intel a également profité de l'IDF pour présenter un Kernel pour Android 4.4, alias KitKat, adapté à l'architecture 64 bits, secteur dans lequel la société sera présente avec les [Atom Z3480 Merrifield et Moorefield pour smartphones](#). Ces deux gammes cibleront le haut de gamme (Moorefield) et le mainstream (Merrifield) tandis que la puce Atom SoFIA avec modem 3G et HSPA+, annoncée lors de l'IDF, visera le marché en plein boom des smartphones d'entrée de gamme dès la fin 2014.

L'IDF a démontré les fermes intentions affichées par Intel de regagner des couleurs sur le marché de la mobilité avec un large panel de produits. La firme de Santa Clara mise largement sur **son process 14 nm pour venir tacler ARM**.

Voir aussi

[Silicon.fr étend son site dédié à l'emploi IT](#)

[Silicon.fr en direct sur les smartphones et tablettes](#)